

カードエッジ対応多層分離 FPC

両面接点のカードエッジコネクタの嵌合に対応した多層フレキシブル基板



両面接点のカードエッジコネクタに対応した端子構造(厚み 1.0 mm)

接続点が無い為、インピーダンス不整合による反射損失を低減



本製品の紹介動画を Youtube で公開中



標準仕様

- ・層数 : 4～6 層
- ・接続 Via : $\phi 0.1$ mm 貫通 Via、 $\phi 0.05$ mm ブラインドフィルド Via
- ・ベース材料 : ポリイミド (PI)
- ・FPC 部厚み : 0.2～0.8 mm 程度
- ・カードエッジ端子厚み : 1.0 mm
- ・表面処理 : ニッケルパラジウム金 (ENEPIG)
- ・インピーダンス整合 : 差動 $100\Omega \pm 8\%$ 、シングル $50\Omega \pm 8\%$

製品特徴

- 部分的に曲げ可能な構造でリジッドフレキ基板と類似機能を有し、高信頼性の Via 形成が可能です
- フレキシブル部とリジッド部が一体化した構造で接続点や Via の切り返しが無く、安定したインピーダンスラインの形成が可能です
- $100\mu\text{m}$ ピッチ配線やランド径 $\phi 300\mu\text{m}$ 以下の Vial によって高密度配線が可能です
- ベアチップのワイヤボンディングや BGA 部品の実装に対応可能です



YAMASHITA MATERIALS